

# MMBT5551W

Rev.E Mar.-2016

## 描述 / Descriptions

SOT-323 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

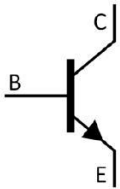
## 特征 / Features

击穿电压高,可与 MMBT5401W 互补。  
High voltage, complementary pair with MMBT5401W.

## 用途 / Applications

用于普通高压放大。  
General purpose high voltage amplifier.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter      PIN 2 : Base      PIN 3 : Collector

## 印章代码 / Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	A	B	C
$h_{FE}$ Range	50~150	100~300	200~400
Marking	HG1A	HG1B	HG1C

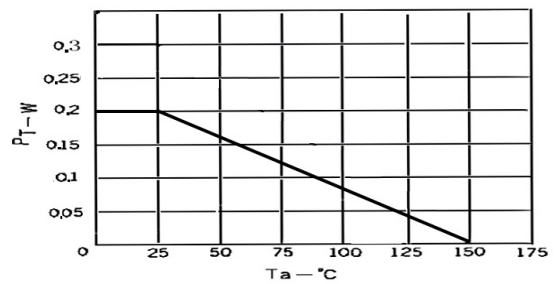
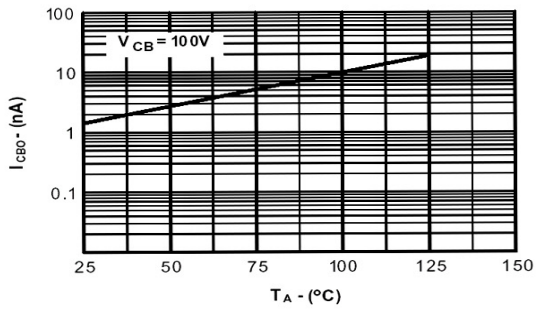
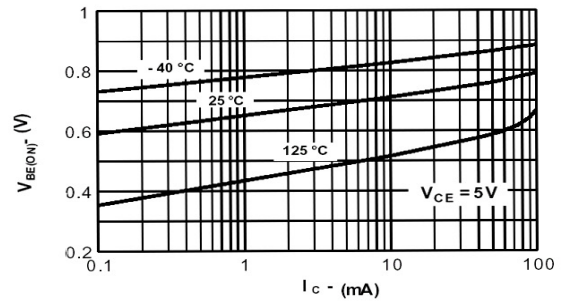
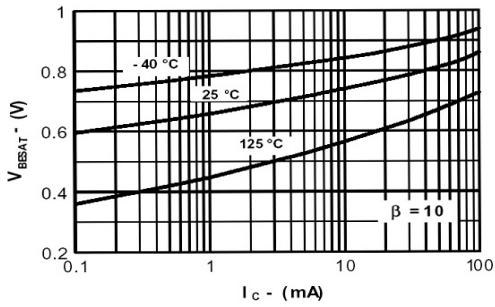
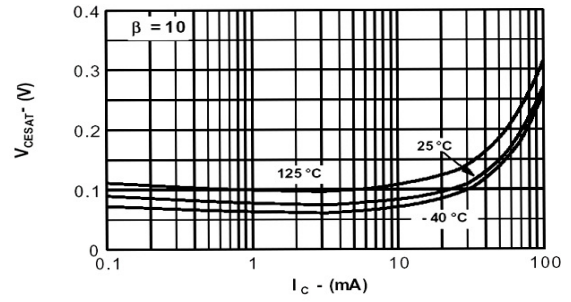
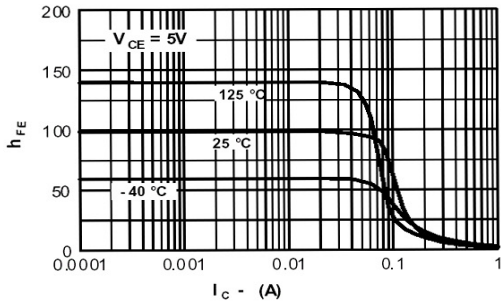
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	180	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	160	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	600	mA
Base Current - Continuous	$I_B$	300	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	200	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=180V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter to Base Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	50	200	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=50mA$	20	160		
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	40	190		
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.06	0.15	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.09	0.3	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.7	1.0	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.8	1.0	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$		0.68	0.75	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	50	110		MHz
Collector output capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	5.0	pF
Turn-On Time	$t_{on}$	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.3		$\mu s$
Turn-Off Time	$t_{off}$			0.4		$\mu s$
Storage Time	$t_{stg}$			0.2		$\mu s$

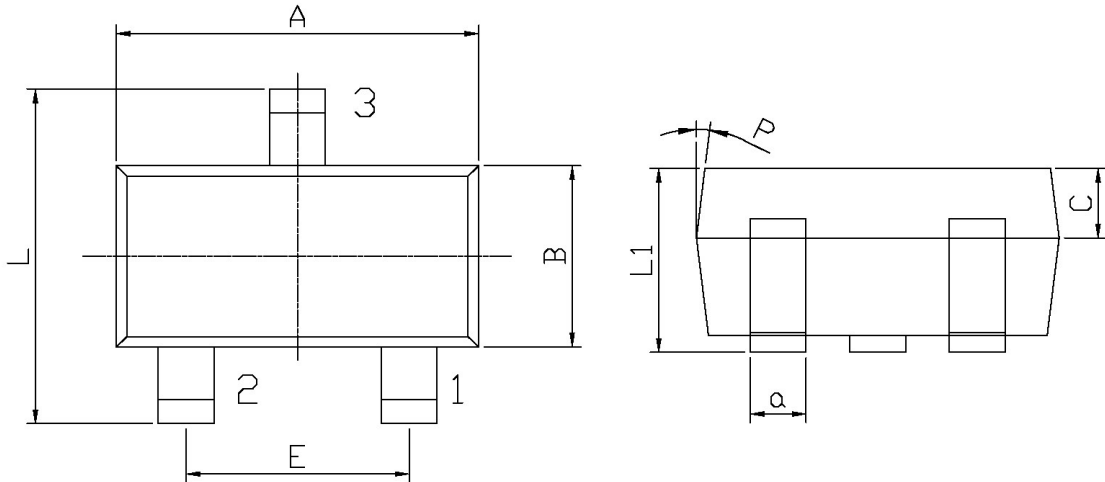
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

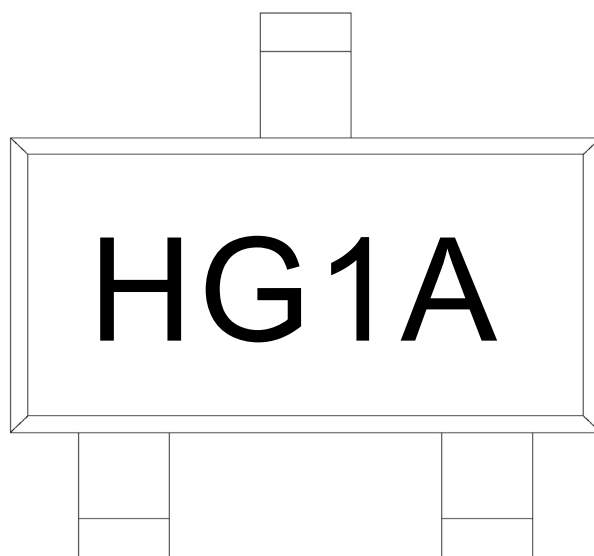
SOT-323

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	1.95	2.35	C	0.30	0.50
L	2.00	2.2	L1	0.85	1.15
E	1.20	1.40	a	0.20	0.40
B	1.15	1.35	P	7°	

印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

G1： 为型号代码

A： 为  $h_{FE}$  分档代码

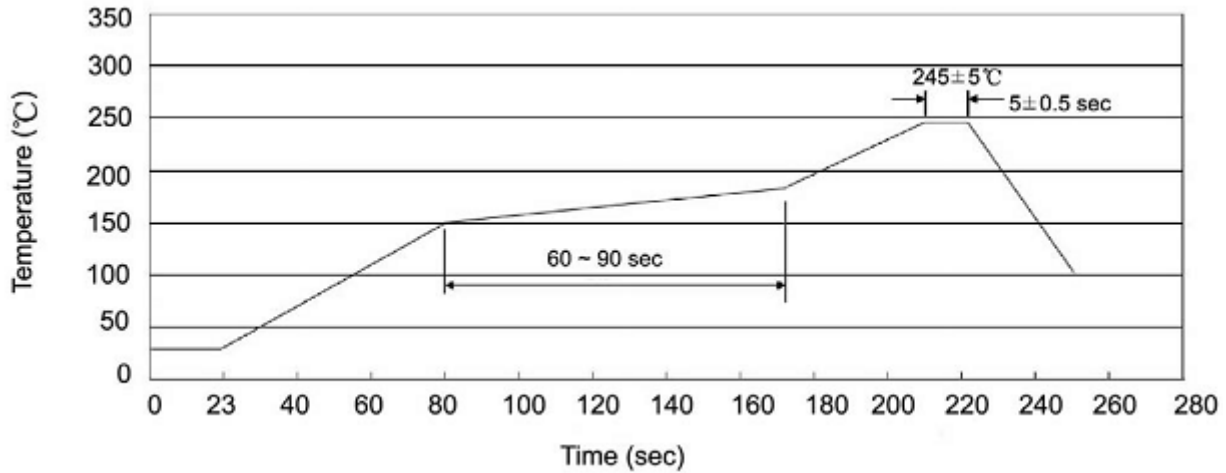
Note:

H: Company Code.

G1: Product Type.

A:  $h_{FE}$  Classifications Symbol

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	8	240,000	7" x8	180×120×180	385×257×392

**使用说明 / Notices**